



RE900-04

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestito con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per TSOP I 16, 24, 28, 36 (0,65 mm)
- Diametro del foro 1,00 mm
- I dati Gerber per la produzione della pasta di saldatura vengono messi a disposizione gratuitamente su richiesta
- Dimensioni 16,73 x 43,64 mm

N. modulo	Tipo	Pitch	Pin	Dimensioni (mm)
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00